

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成19年12月13日(2007.12.13)

【公開番号】特開2005-138586(P2005-138586A)

【公開日】平成17年6月2日(2005.6.2)

【年通号数】公開・登録公報2005-021

【出願番号】特願2004-317451(P2004-317451)

【国際特許分類】

B 4 1 J 2/045 (2006.01)

B 4 1 J 2/055 (2006.01)

【F I】

B 4 1 J 3/04 103 A

【手続補正書】

【提出日】平成19年10月31日(2007.10.31)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

流体流路層と、

前記流体流路層上に配設されたダイヤフラム層と、

前記ダイヤフラム層の表面上に形成された粗面化された接着領域と、

前記粗面化された接着領域上に配設されたコンフォーマルな隆起した接触領域を有する薄膜回路と、

複数の電気機械変換器と、

を備える液滴放出装置であって、前記電気機械変換器が、前記コンフォーマルな隆起した接触領域と前記電気機械変換器との間に形成された凹凸接触によって、前記コンフォーマルな隆起した接触領域に接着するように取り付けられているとともに、前記コンフォーマルな隆起した接触領域に電気的に接続されている液滴放出装置。

【請求項2】

請求項1に記載の液滴放出装置であって、前記隆起した接触領域が、コンフォーマルな誘電体メサを含む液滴放出装置。

【請求項3】

請求項1に記載の液滴放出装置であって、前記隆起した接触領域が、コンフォーマルな導電性メサを含む液滴放出装置。

【請求項4】

請求項1に記載の液滴放出装置であって、前記薄膜回路が、コンフォーマルなメサ層と、前記コンフォーマルなメサ層の上を被覆するパターン形成されたコンフォーマルな導電性層と、を含んで構成されている液滴放出装置。

【請求項5】

請求項1に記載の液滴放出装置であって、前記薄膜回路が、コンフォーマルなプランケット誘電体層と、前記コンフォーマルなプランケット誘電体層の上を被覆するコンフォーマルなメサ層と、前記コンフォーマルなメサ層の上を被覆するパターン形成されたコンフォーマルな導電性層と、を含んで構成されている液滴放出装置。

【請求項6】

請求項1に記載の液滴放出装置であって、前記薄膜回路が、コンフォーマルなメサ層と

、前記コンフォーマルなメサ層の上を被覆するコンフォーマルなプランケット誘電体層と、前記コンフォーマルなプランケット誘電体層の上を被覆するパターン形成されたコンフォーマルな導電性層と、を含んで構成されている液滴放出装置。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の液滴放出装置であって、前記薄膜回路が、パターン形成されたコンフォーマルな導電性層と、前記パターン形成されたコンフォーマルな導電性層の上を被覆するコンフォーマルな導電性メサ層と、を含んで構成されている液滴放出装置。

【請求項 8】

請求項 1 に記載の液滴放出装置であって、前記薄膜回路が、コンフォーマルなプランケット誘電体層と、前記コンフォーマルなプランケット誘電体層の上を被覆するパターン形成されたコンフォーマルな導電性層と、前記パターン形成されたコンフォーマルな導電性層の上を被覆するコンフォーマルな導電性メサ層と、を含んで構成されている液滴放出装置。